

证券代码：301369

证券简称：联动科技

佛山市联动科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：投2025-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他 <u>(请文字说明其他活动内容)</u>
参与单位名称及人员姓名	广发证券、大兴华旗、赢仕投资、九一基金、百瑞信托等机构以及个人投资者（排名不分先后）
时间	2025年12月2日下午14:00-15:00、 2025年12月3日上午10:00-11:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书 邱少媚
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司如何看待全年的行业景气度？</p> <p>回复：2025年半导体行业会继续延续复苏趋势。SEMI预计，2025年全球半导体设备销售总额将达到1,255亿美元，同比增长7.4%，2026年销售总额将达到1,381亿美元。在AI算力、汽车、消费电子等领域的推动下，半导体测试设备市场将继续维持较高的增长比例。</p> <p>2、公司的主要业务构成如何？</p> <p>回复：公司具有丰富的产品线，主要产品包括半导体自动化测试系统、激光打标设备和其他机电一体化设备，能够满足其不同产品在封测产线上不同工艺环节的细分需求，具备设备整体交付和封测产线配套综合服务能力。</p>

目前公司的主要业务聚焦在半导体自动化测试系统，该类系统主要覆盖功率半导体和模拟及数模混合集成电路测试系统领域，占公司营业收入的比例约为90%。

3、公司是否有并购的规划？

回复：公司在集中精力做好主业的同时，也一直在关注行业内合适的投资机会。在合适的时机，公司会寻求产业整合度较高的标的做一些上下游或横向并购的尝试。

4、公司SOC测试设备目前有什么进展？

回复：公司正在全力推进大规模数字SOC类集成电路等测试领域的研发和验证工作，由于产品复杂度高，验证周期较长，产品尚未量产。

目前，国内高端SOC测试机国产化率比较低，国产替代、自主可控、降低测试成本以及AI数据中心算力和端侧AI应用的发展，公司看好该领域所带来的确定性市场机会，公司将加大该领域的研发和市场投入。

5、公司有哪些研发重点？

回复：自上市以来，公司一直保持较高的研发强度，2025年1-9月研发投入占营业收入的比例超过33%。公司的研发重点围绕半导体测试设备的高端化（如SOC测试）、全流程化和国产替代展开，旨在抓住AI算力、先进封装、车规芯片等市场机遇。

6、公司在海外有没有布局？

回复：公司已经在香港和马来西亚设立了全资子公司，当地员工进行海外市场开拓，为海外客户提供更多本土化和即时性的服务。

	7、公司募投项目中的“扩产建设项目”主要是针对哪些产品？ 回复：“扩产建设项目”涉及的产品包括公司全系列半导体测试设备、激光打标设备和其他机电一体化产品。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2025年12月2日、2025年12月3日